

2006年12月5日

メッキ用銅ボール製造設備を増強、年間4万トン体制へ

三菱マテリアル株式会社(本社:東京都千代田区 社長:井手明彦)の銅事業カンパニーは、堺工場(大阪府堺市)において、半導体プリント基板などの電気メッキ用銅ボールの生産設備を増強し、生産量を現在の年間2万トンから4万トンへと大幅に増強することとしました。設備投資金額は約3億円、平成19年春に完成の予定です。

当社は銅製錬から銅加工まで自社で手がけており、素材から加工まで一貫した技術をもって顧客ニーズに応えています。銅ボールも自社開発した無酸素銅を原料とし、高純度でメッキ溶解性に優れ、品位が非常に高いことからスラッジ発生量が極めて少ないなどの特徴を持ち、国内市場トップ、世界市場でもトップクラスのシェアを有しています。

銅ボールは主に携帯電話やパソコン、その他電気製品に使用される各種プリント基板の電気メッキ用に使用され、電子デバイスの高密度化などに伴い、近年、日本を含む東南アジアでの需要が著しく増加し、年率10%以上の伸びが見込まれています。

このような状況のもと、当社は安定的な供給体制を確立するため、堺工場での製造設備増強を行い来年度以降、4万トン体制を整えることにしたものです。当社はこれを契機に、品質、納期等において顧客ニーズを先取りし、銅ボール事業を発展させてまいります。

以 上

<ご参考>



銅ボール